LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI12_3+6b+3_1,50_35

12 - Lagen

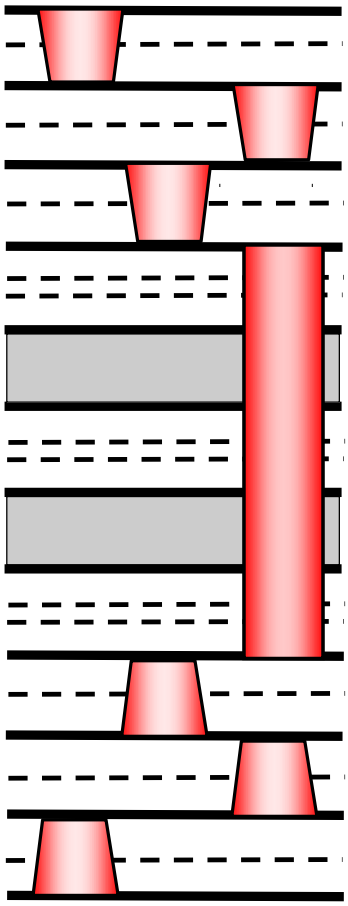
Kern: 0,51 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.: | **3 + 6B + 3**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

vorl. nur CBT Schopfheim

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK3		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
3	VSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
4	VSK1			12 µm		35	
					2 x 1080	133	
5	2			35 µm		33	
			0,200 mm			200	
6	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
7	4			35 µm		33	
			0,200 mm			200	
8	5			35 µm		33	
					2 x 1080	133	
9	RSK1			12 µm		35	
					1 x 1080	60	
10	RSK2			12 µm		30	
					1 x 1080	60	
11	RSK3		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
					Gesamtdicke Material:	1496	
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)		

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,13	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,16	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,18	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:	20-
29.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00		